

Kyron® 2204 高性能セラミックPEEK

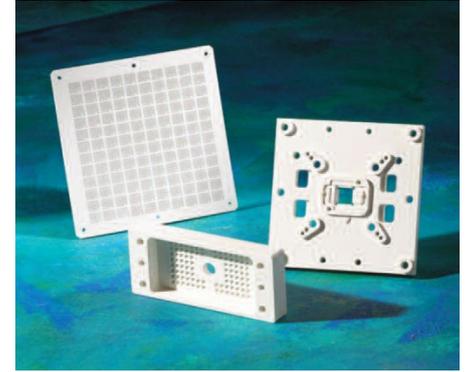
Kyron® 2204は、半導体用テストソケットなどに最適なセラミック入りPEEK（ポリエーテルエーテルケトン）樹脂です。

切削加工性が非常に良好で、複雑形状や微細加工が必要な切削品に広く使われております。

吸水率が低く寸法変化が小さいため、高精度を必要とされる部品に適しています。

機械強度も非常に高く、耐薬品性、耐熱性にも優れた材料です。

材料色は、白とグレーから選択いただくことが可能です。



おもな特色

- 切削加工性
 - 低吸水性
 - 高耐熱
 - 高耐薬品性
 - 色選択可
- 切削加工性が良好で、複雑形状や微細加工が可能です
 - 吸水による寸法変化や強度変化が極めて小さいです
 - -40℃～260℃と広い温度領域で使用可能です
 - 多くの有機・無機薬品に高い耐性があります
 - 白とグレーから選択可能です

一般物性

項目	測定方法	単位	Kyron® 2204
			セラミックPEEK
引張強度	D638	MPa	107
引張伸び	D638	%	21
引張弾性率	D638	MPa	4,964
曲げ強度	D790	MPa	183
曲げ弾性率	D790	MPa	5,171
圧縮強度	D695	MPa	124
ロックウェル硬度 (R)	D785	-	125
アイゾッド衝撃強度 (ノッチあり)	D256	J/m	53
アイゾッド衝撃強度 (ノッチなし)	D256	J/m	no break
融点	DSC	℃	343
ガラス転移点 (Tg)	DSC	℃	143
連続使用温度 (RTI)	UL746B	℃	240
熱変形温度 @1.82MPa	D648	℃	315
線膨張係数	D696	10 ⁻⁵ /℃	3.60
熱伝導率	C177	W/mK	0.35
比重	D792	-	1.51
吸水率 24h, @23℃	D570	%	0.37
絶縁耐力, S/T, in oil	D149	kVmm ⁻¹	16
誘電率	D150	MHz	1, dry 3.5
誘電正接	D150	MHz	1, dry <0.0050
体積/表面抵抗率	EOS S11.11	ohm sq	1.0 x 10 ¹⁴

* 上記数値は代表値であり、その完全性・正確性を保証するものではありません。